

## 供媒體即時發佈

### 投資關係者：

Ed Lockwood  
投資者關係資深總監  
(408) 875-9529  
ed.lockwood@kla-tencor.com

### 媒體關係者：

Meggan Powers  
企業宣傳資深總監  
(408) 875-8733  
meggan.powers@kla-tencor.com

## 推出新款

## 薄膜量測機台

【加州 MILPITAS 2010 年 8 月 4 日訊】今天，專為半導體和相關產業提供製程控制與良率管理解決方案的全球領先供應商 [KLA-Tencor Corporation](#) /美商科磊（納斯達克股票代碼：[KLAC](#)）今天推出的最新產品，讓 Aleris 系列薄膜量測機台又添一生力軍。作為專為測量關鍵性薄膜而設計的現有 Aleris 8350 的互補，[Aleris 8330](#) 是穩定、極具生產價值和低購置成本的測量解決方案，能夠測量 32 奈米以及更小線寬世代的一般薄膜的厚度、折射率和應力。極具成本效益的 Aleris 8330 和高度靈敏的 Aleris 8350 組成了適用於各種薄膜層的綜合解決方案，有助於半導體製造廠在生產中篩檢製程問題，並保持較高良率。

KLA-Tencor 的薄膜與散射測量技術部 (FaST) 副總裁兼總經理 Ahmad Khan 表示：「許多半導體製造廠都已採用高性能與擴展性的 Aleris 系列量測機台，但同時希望針對一般性薄膜的生產監控採用較低成本效益的機台版本。Aleris 8330 可以為半導體製造廠在 Aleris 系列量測機台上提供了良好成本效益的方法，或讓已經採用 Aleris 系列量測機台的半導體製造廠將整廠薄膜測量能力更進一步擴展與最佳化。Aleris 8330 提供了比我們的前世代 ASET-F5x 量測機台更高的產能。此外，不同型號的 Aleris 系列量測機台之間的量測程式共用和降低機台量測差異化，有助於縮短生產整合時間，並提升半導體製造廠的營運效率。這些優勢對所有半導體製造廠都極具吸引力，特別是面臨市場挑戰的記憶體製造廠。製造

\*關鍵薄膜，例如超薄擴散層，通常有最小的線寬和最窄的製程變異容許度。在半導體生產製程中，由大多數薄膜層構成的一般薄膜具有更大的製程變異容許度，並且包括諸如金屬間電介質(inter-metal dielectrics)、光阻膜 (photoresists)